

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2026年6月16日)

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	财通基金、德邦基金、东方红资管、广发基金、国泰基金、汇添富基金、华夏基金、混沌投资、交银施罗德基金、摩根基金、太平基金、天弘基金、万家基金、信达澳亚基金、兴业基金、兴银理财、长江养老、招商基金、中银基金
活动时间	2026年6月9日、6月10日、6月11日、6月12日
活动地点	策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：唐超宇、杨丽颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q1：如何展望 SLC NAND Flash 下半年的价格趋势？</b></p> <p>答：自 2025 年下半年以来，受海外存储大厂持续退出消费类市场、关停 2D NAND 产线影响，供给端明显收缩，公司 SLC NAND 产品季环比价格实现一定比例上涨。目前来看，利基型存储供需失衡状况短期内仍将存在。供给端，主要厂商产能向 3D NAND、HBM 等高端产品倾斜，利基型存储上游供应持续减少；需求端，工控、网通、车用电子等应用稳步复苏对产品价格形成有力支撑。综上，SLC NAND 价格趋势方向有望继续保持向上。公司继续深化与国内外晶圆代工厂及封测厂的战略合作，保障产能供应，并动态调整生产规模以匹配客户需求；另一方面，持续推进 1xnm 及 2xnm 制程 SLC NAND 的研发与量产，扩充产品料号，优化产品结构，积极把握行业结构性复苏机遇。</p> <p><b>Q2：公司如何判断此轮涨价的持续性？</b></p> <p>答：公司对本轮利基型存储涨价持续性的判断主要基于供给、需求、产能周期三维度综合分析。供给端：本轮涨价核心驱动来自全球存储产业的供给侧结构性调整——海外头部厂商陆续战略性退出 2D NAND 市场，将产能资源向 HBM 等高附加值的高端存储产品倾斜，导致通用型</p>

及利基型存储的有效供给持续收缩。同时，晶圆代工成本呈稳步上升态势，从成本端进一步支撑存储产品价格上行。需求端：与主流通用存储相比，利基型存储价格传导存在一定滞后性，但下游需求基本面更为稳健：工控、车用电子、通信等核心应用领域需求保持稳步增长，且 SLC NAND 在高可靠性、高耐久性等关键性能指标上具备不可替代性，下游客户需求具有持续性与刚性特征。产能周期：从全球存储代工产能投放节奏看，新一轮扩产周期的大规模产能释放落地需要时间，短期内供给缺口难以有效弥补。根据 Gartner（高德纳）最新行业研判，NAND Flash 涨价周期有望延续至 2027 年以后。综上所述，本轮利基型存储的涨价趋势有望继续延续。以上分析基于当前行业环境判断，仅供投资者参考，具体经营数据请以公司定期报告及临时公告为准，敬请注意投资风险。

**Q3：公司目前的市占率情况如何？未来市占率是否会进一步提升？**

答：公司深耕存储芯片领域多年，是国内少数可同时提供 NAND、NOR、DRAM 完整存储解决方案的厂商。公司持续布局 SLC NAND Flash 的新制程开发及多样化产品拓展，形成核心竞争优势，市场份额居大陆厂商第一梯队。展望未来，公司将立足存量市场稳步经营，持续夯实网络通信、消费电子等基本盘，同时深化与国内外晶圆代工厂及封测厂的战略合作，保障供应链稳定与产能弹性。产品端方面，公司车规级存储布局已取得阶段性成果，SLC NAND、NOR 及 MCP 产品均通过 AEC-Q100 车规验证，成功进入国内多家整车厂白名单并在多款车型实现规模量产；工控领域市场渗透率也在稳步提升。当前海外大厂持续退出 2D NAND 市场，存储产业国产替代进程加速，公司凭借多年技术积累、完整产品矩阵及优质客户资源优势，核心产品市场占有率有望进一步提升。

**Q4：公司存储业务未来的发展规划如何？是否考虑做 3D NAND 和 HBM？**

答：公司持续围绕“存、算、联”一体化战略推进技术研发与产品迭代。存储芯片方面，公司 1xnm 闪存产品已实现量产并实现产品销售，设计与工艺持续优化；稳步推进 2xnm 制程 SLC NAND Flash 系列研发，持续扩充产品料号；基于 48nm 及 55nm 制程推进中高容量 NOR Flash 产品研发；DRAM 方面已实现 DDR3(L)、LPDDR1/2/4X 及 PSRAM 量产；持续研发更多 MCP 容量组合方案；车规级产品方面，多款型号已通过 AEC-Q100 验证，公司已通过 IATF 16949:2016 质量管理体系第三方符合性认证，并成功完成多家整车厂的白名单导入。未来，公司将继续积极关注存储芯片技术的演进趋势，在扎实做好现有高可靠性产品的基础上，结合行业供需变化、客户实际需求以及自身资金与技术实力，对产品品类的扩充及不同制程的迭代进行充分论证与审慎规划。公司目前主要聚焦于利基型存储芯片，对于 3D NAND 和 HBM 产品的研发公司暂无相关安排，将保持对新技术发展的持续关注。感谢您的关注！

**Q5：公司下游客户结构如何？**

	<p>答：公司下游客户主要集中在网络通信、安防监控、消费电子、工业控制与汽车电子等领域。</p> <p><b>Q6：公司存储芯片产能是否有扩张？</b></p> <p>答：公司采用 Fabless 经营模式，专注于芯片的研发设计与销售。公司采取“本土深度、全球广度”的供应链策略，与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了长期稳定的战略合作关系。2026 年，公司正有序加大主要存储产品线的生产与备货力度，以匹配下游市场需求的持续复苏。公司将根据市场供需变化和客户订单情况，动态调整投产规模，保障产能供应的稳定性与连续性。</p> <p><b>Q7：WiFi 7 联接芯片当前进展？</b></p> <p>答：公司的 WiFi 7 芯片聚焦高端黑电透传场景，已于 2025 年完成原型机样片测试，其核心性能符合设计目标。公司正积极推进相关产品的研发工作，未来随着产品逐步完成客户导入并实现量产，有望为公司带来新的收入增长曲线。具体的营收确认时间取决于客户导入进度和量产节奏，可关注公司后续公告。</p> <p><b>Q8：砺算科技当前销售情况如何？专业卡和消费卡的比例如何？下游客户主要是哪些？</b></p> <p>答：砺算科技的专业卡已在 2025 年开始进行交付，消费级显卡已公开发售。目前，砺算科技的产品销售正在按计划有序推进，具体产品销售情况以砺算科技官方信息为准。下游应用方面，消费级显卡主要面向个人用户；专业级显卡可广泛适配数字孪生、专业设计、视频编解码、影视动漫、云游戏、云渲染、AI PC、空间智能等领域客户需求。</p>
日期	2026年6月16日